

EDITORIAL

Anwendungen der Leistungselektronik 1353

VERBÄNDE

 **FBDi - Informationen** 1401

 **FED - Informationen** 1411

 **ZVEI: - Informationen** 1448
Die Elektroindustrie

 **MAPS - Mitteilungen** 1472
Microelectronics Packaging Society

 **3-D MID - Informationen** 1488

 **DVS - Mitteilungen** 1516

AKTUELLES

Nachrichten/Verschiedenes 1356

Neue Normen 1371

Tagungen/Fachmessen/Weiterbildung 1372

SMT Hybrid Packaging 2013 – Messebericht letzter Teil 1376

BAUELEMENTE

ZVEI-Trendanalyse 2017: Asien ist der Hauptmagnet für Halbleiterfertigung und -anwendung 1388

Dünnschicht-Abschlusswiderstände auf CVD-Diamantträger 1394

Osram optimiert LEDs für breite Anwendungen 1395

HY-Line mit drei neuen Komponenten 1399

DESIGN

Leap Motion zeigt Gestensteuerung für Windows 1405

Cadence stellt neue Tempus-Timing-Sign-off-Lösung vor 1406

DESIGN

Target 3001 unterstützt Magic-PCB, die RFID-Technologie von PCB-Pool 1407

Kompakte High-End-Tower-CPU-Kühler 1408

Neuer Blutdruckmesser ohne Manschette 1410

LEITERPLATTENTECHNIK

Auf den Punkt gebracht (H.J. Friedrichkeit)
Europas Automobilabsatz schwächelt –
Aber dynamisches Wachstum in China und den USA 1421

Die Leiterplattenindustrie 2012 in Europa 1424

Mit Portfoliobereinigung, Stabilisierung und neuem Geschäftsfeld will AT&S erfolgreich bleiben 1430

Wenn Roboter Spaß haben 1434

Prozessorkarte verspricht mehr Leistung bei bester Kosteneffizienz 1436

Solide Umsatzerfolge und Neuinvestitionen – Leiterplattenhersteller B&B auf Erfolgskurs 1438

Spezialisierung zur erhöhten Wertschöpfung bei der Leiterplattenfertigung – welche Vorteile hat Europa? 1439

BAUGRUPPEN & SYSTEME

Der negative Einfluss von Phosphor in Ni-dotierten Loten 1455

Wärmeleitender Kleber erreicht handfeste Verbindung nach vier Minuten 1463

Elektropolieren und Nanobeschichten sorgen für weniger Lötfehler 1464

Göpel integriert modernste JTAG-Standards in einem Chip und startet Kooperationsnetzwerk 1466

Elektronische Applikationen für den Automobilbereich 1468

Siplace Split Table Mode: Virtuelle Wechseltische ermöglichen Produktwechsel ohne Stillstandszeiten 1471

ANALYTIK & TEST

Sinn und Möglichkeiten der elektrischen Baugruppenprüfung 1479

Vielseitige AOI-Konfiguration mit hohem Durchsatz 1486

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Herstellung, Charakterisierung und Verarbeitungsansätze metallischer Nanodraht-Arrays	1491
Thermo-mechanische Charakterisierung des TSV-Annealing	1498
Non-Destructive Failure Analysis of Packaged IGBT Modules by Scanning Acoustic Microscopy	1508
Patente	1511

FORUM

Microelectronics Saxony – Zukunft Energie	1518
Kolumne – Anders gesehen: Schräge Witze der amerikanischen Prozessingenieure	1528
PLUS-Firmenverzeichnis	1530
Firmenindex	1554
Inserentenindex	1557
Anzeigenformate und Preise	1558
Impressum	1559
Produkt des Monats	1560

Titelbild: Cadence liefert 1x im Quartal ein Zwischenrelease für OrCAD und Allegro mit jeweils neuen Funktionen. Im Juli 2013 kommt das Scribble Routing hinzu. Mehr Informationen erhalten Sie bei FlowCAD.
www.flowcad.de

Die Fachzeitschrift PLUS ist das Organ folgender Fachverbände:



Fachverband Bauelemente Distribution e.V.,
 Tel. +49/8165/670233,
w.ziehfuss@fbdi.de, www.fbdi.de



Fachverband Electronic Components and Systems
 Tel. +49/69/6302-276 bzw. -251,
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org



Fachverband Elektronik-Design e.V.,
 Tel. +49/30/8349059,
info@fed.de, www.fed.de



Fachverband PCB and Electronic Systems
 Tel. +49/69/6302-437,
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org



INTERNATIONAL MICROELECTRONICS AND PACKAGING SOCIETY – Deutschland e.V.,
 Tel. +49/3677/69-3381,
jens.mueller@imaps.de,
www.imaps.de



Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e.V.
 Tel. +49/91 1/5302-9100,
info@3dmid.de, www.3dmid.de



European Interconnect Technology Initiative e.V.
 Tel. +49/69/6302-281,
eiti@zvei.org, www.eiti.org



DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V.
 Tel. +49/211/1591-0,
michael.weinreich@dvs-hg.de,
www.dvs-ev.de

Die offiziellen Verbandsmitteilungen an Mitglieder und Fachwelt erscheinen monatlich in der PLUS.